

SPOLEČNOST MAROX S.R.O. VÁS SRDEČNĚ ZVE NA 2. ROČNÍK SEMINÁŘE



MAROX SEMINÁŘ INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ PRO ELEKTROTECHNIKU



16. května 2019

Hotel Rozálka / Kongresový salonek
Pezinok, Slovensko

08.00 - 08.20	Registrace
08.20 - 08.30	Představení společnosti Radoslav Holička (MAROX)
08.30 - 09.15	Program na redukci bublin v spoji Corné Hoppenbrouwers (ALPHA) Reflow pece, typy pájecích past, profilovací pasta, slitiny a chemické složení, povrchové úpravy PCB, velikosti prášku, návrh šablony, další možnosti snižování výskytu bublin
09.15 - 10.00	Materiály na čištění PCB a šablon používaných při výrobě elektroniky Marko Navijalić (KYZEN) PCB čištění, co znamená "Žádné čištění" (No Clean), Čištění "No Clean", úvahy o návrhu desky, energie čistícího stroje, kontrola procesu, ověření procesu
10.00 - 10.15	Přestávka
10.15 - 10.40	Ověření procesu a analýza poruch Martino Taddei (GESTLABS) Laboratorní techniky, testy k ověření procesu, technologie, produkty
10.40 - 11.10	IPC 1601-A Zbytková vlhkost v PCB - Kritické problémy a zkušenosti Guglielmo Martinelli (TECNOMETAL) Všeobecná usměrnění, účinky vlhkosti na PCB, balení, zlepšování bezpečnosti, skladování a používání PCB, sušení
11.10 - 11.35	Systém identifikace jako základní koncept pro sledovatelnost výrobního procesu Richard Tomík (BRADY) Vysokokvalitní etikety pro každou aplikaci, softwarová řešení workstation, hardwarová řešení jako průmyslové aplikátory, tiskárny a čtečky 2d, datmatrix kódů
11.35 - 12.25	Oběd
12.25 - 13.15	Bezolovnaté nízkotavitelné slitiny Corné Hoppenbrouwers (ALPHA) Slitina CVP520 SnBiAg, slitina OM535

13.15 - 13.45	Představení produktů a služeb, čistící řešení Janez Kopac (CEPTER) Přesné čištění, čištění šablon, údržbové čištění, služby čištění
13.45 - 14.30	Redukce bublin pomocí Alpha Preforms Daniele Perico (ALPHA) Redukce bublin pod spodním zakončovacím komponentem (BTC), představení ALPHA Accu Flux BTC-578 – pájecí předlisky
14.30 - 14.45	Přestávka
14.45 - 15.30	Čištění šablon Marko Navijalić (KYZEN) Proč je třeba čistit šablonu, význam čistých šablon, stírání spodní části pod šablonou, IPA výzvy, automatické čištění šablon
15.30 - 16.00	SMD šablony Alpha Sama Szalay (ALPHA) Stupňové šablony: chemické leptání vs. přesné frézování, napínací systém Alpha TensoRED, typ fólie HR2 pro šablonu
16.00 - 16.30	Problémy a řešení v elektronice Norbert Süli (ALPHA) SMD výroba, pájení vlnou, selektivní pájení, ruční pájení
16.30 - 17.00	Diskuze
17.00	Ukončení semináře
od 19.00	Večeře

Jste srdečně vítáni!
Organizátoři semináře se těší na Vaši účast.



Radoslav Holička
Marox, s.r.o.
Obchodně-technický zástupce

Ing. Roman Lacko
Marox, s.r.o.
Technický ředitel